# SEST AVAILABLE COPY

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-305915

(43)Date of publication of application: 28.10.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/027

GO3F 7/20

(21)Application number: 03-094867

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

02.04.1991

(72)Inventor: OZEKI HISAO

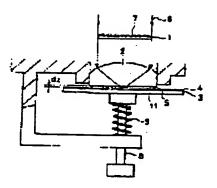
MATSUBARA TAKASHI

# (54) ADHESION TYPE EXPOSURE DEVICE

# (57)Abstract:

PURPOSE: To make thin the film thickness of an immersion liquid interposed between a photo-mask or an optical projection system and a wafer and reduce the quantity of light absorbed, and to minimize and prevent exposure unevenness in an adhesion type exposure device.

CONSTITUTION: A wafer 3 coated with a photoresist 4 is fast stuck on an exposure lens 2 through an immersion liquid 5. A surface-active agent 11 is mixed into the immersion liquid 5 within a range that the photoresist 4 is not affected, and the surface-active agent 11 reduces the surface tension of the immersion liquid 5, and improves wettability. Accordingly, the film thickness d2 of the immersion liquid is made thinner than the case where surface-active agent is not mixed.



# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出關公則各号

# 特開平4-305915

(43)公闆日 平成4年(1982)10月28日

(51) Int CL' H 0 1 L 21/027	識別記号	庁內蓋亞番号	FJ	技術表示旨所
G03F 7/20	5 2 1	7818—2H 7352—4M	H01L 21/30	311 A

### 審監請求 未需求 請求項の数1(全 3 頁)

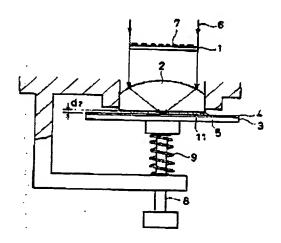
(21) 出題番号	特頭平3-94867	(71)出題人 900004112	
(22) 出頭日	平成3年(1991)4月2日	株式会社ニコン 東京都千代田区丸の内3丁目 2 番 3 号	
		(72)発明者 大岡 尚夫	
		東京都品川区西大井一丁目 6 余 3 号 (会社ニコン大井銀作所内	統武
		(72) 死明を 松原 隆	
		東京都品川区西大井一丁目 6 番 3 号 電会社ニコン大井銀作所内	东式
		(74)代理人 分產士 山川 政資	

# (54) 【発明の名称】 密符数質光核器

# (57) 【芸約】

【目的】 密管型電光装置において、フォトマスクまた は投影光学系とウエハとの間に介在される没破の設備を 静くして光の吸収量を少なくし、露光ムラを経対防止す ることを目的とする。

【構成】 フォトレジスト4を登布されたウエハ3を露 光レンズ2に侵被5を介して疲労させる。 寂底6にはフ ォトレジスト4に影響を与えない範囲で界面活性剤11 が混入されており、界面活性剤11は、侵被5の表面張 カを減らし、満れ性を高める。したがって、侵彼の膜厚 dz は界面活性剤を混入しない場合より得くなる。



(2)

特朗平4~305915

### 【特許確求の範囲】

【助求項1】 フォトレジストを整布されたウエハを投 形光学系もしくはフォトマスクに足被を介して審着さ せ、限財光の原射によりフォトマスクのパターンを前配 フォトレジストに転写するようにした密を理論光衰器に おいて、前配浸漉は前配フォトレジストに影響を与えな い範囲で昇国器性剤が配入されていることを停徹とする 密着質響光衰退。

1

# [発明の辞細な説明]

100011

【産業上の利用分野】本発明は、LSIの製造工程において、フォトマスク上のパターンをウエハ上に投影器光するמ光装置、特に密着型象光装置に関するものである。

# [0002]

【従来の技術】レーザー光等を展射しフォトマスク上の パターンを投影光学系によってシリコンウエハ等の半導 体基板上に投影電光するこの種の電光英語における開光 方式としては、①密着(コンタクト)電光方式、②プロ キシミティ観光方式、②反射型投影観光方式、②常小レ ンズ投影電光方式の4方式が知られている。

【6603】このうち密着盛光方式は、フォトマスク (または後影光学系)とウエハとを密着させて鑑光する もので、これらが完全に審着している場合には、フォト レジスト中の数量が風折率分の1に短くなるため、回折 の影響が少なく、高解像度の転写が得られるという特色 を有している。この陪着は真空受着、静電チャック等に よって行っている。しかし、完全な密着を実現すること は極めて難しく、またフォトマスクとウエハとを機械的 に接触させているためにウエハ表面の突起等によりフォ トマスクに欠陥が生じ、その寿命を低下させると同時に デバイスの浄智りに影響を及ぼすといった問題があっ た。

【0004】そこで、密宮郷光方式によるこのような問題を解決する方法としてフォトマスクとウエハ間に被体(侵被)を充填している。四2はウエハを投液を介して投影光学系に密意させた場合を示すもので、1はフォトマスク、2は投影光学系の一部を構成する原光レンズ、3はフォトレジスト4が整布された皮膜、6はフォトレジスト4が関がしてカーンで、5は8光マスク1のパターンで、6はフォトレジスト4を開光する保持体、9は保持体8を上方に付券しウエハ3を保持する保持体、9は保持体8を上方に付券しウエハ3を保持する収益化フェインでは、20世界である。限射光6の波長は短いである。限射光6の波長は短いである。限射光6の波長は短いでがするに対すの影響が少なく、そのため光度としてエキシマレーザー等のレーザー鏡罩が用いられる。没被5とレボタレーボストイと認力による。しかもフォトレジストイを密かさないものが望ましく、通常純水が使用される。

[0005]

【契明が無決しようとする課題】しかしながら、上述したような浸液5を使用した糖材型能光度器においては、 浸液5向身の製料ムラがあると、浸液5による果材光6の機収量にムラが生じるため、コンタクト最光されたフォトレジスト4のパターンが的確に露光されている部分とそうでない部分とが生じてしまうという問題があった。したがって、このような概光ムラの発生を防止するため、授数5の標れ性を高めて衰闘張力を下げ、原見は「を転力率くすることが空まれている。

○ 【0006】本発明は上述したような従来の問題点および受望に据みてなされたもので、その目的とするところは、没収の環席を輝くし、没放による電光ムラを軽減防止し待るようにした密容型露光設置を提供することにある。

# [0007]

【課題を祭決するための学校】本発明は上記目的を達成するため、フォトレジストを整布されたウエハを投影光学系もしくはフォトマスクに浸液を介して密着させ、風射光の限射によりフォトマスクのパターンを前記フォトンジストに転写するようにした密着型解光数位において、前記浸液は前記フォトレジストに影響を与えない義田で界面活性剤が混入されているものである。

### [0008]

【作用】本発明において界面哲性別は侵族の強れ性を高め、表面强力を下げる。したがって侵険の膜厚を薄くする。

### [0009]

【寒飯例】以下、本発明を図画に示す実施例に基づいて 詳認に説明する。図1は本発明に係る密着型電光変優の 一実施例を示す要部の断面図である。なお、図中図2と 同一義成部品のものに対しては同一符号を以て示し、そ の影响を含めずる。

【0010】本実施例は投影光学系にウエハを密着させた場合を示すもので、フォトマスク投影光学系の一部を 構成する電光レンズ2とウエハ3との間に介在される範 水等の根依5に界面話性刺11を思入したものである。

なが元字系に伝表させた場合を示すもので、1はフォトマスク、2は投影光字系の一部を構成する解光レンズ、3はフォトレジスト4が勤布されたウエハ、5は露光レンズ2とウエハ3間に充填された投版、6はフォトマス の フォトレジスト4を描かしたりすることのない範囲で設入1のパターン7を照射レフォトレジスト4を磨光する 版計光、8はウエハ3を保持する保持体、9は保持体8を上方に付券レウエハ3を熔光レンズ2に所定圧にて押

【0012】かくしてこのような構成においては界面活性刻11が没該5の表面張力を被らして満れ性を高めるため、ウエハ3を所定圧力にて電光レンズ2に圧接した際、没該5の膜厚d。を図2に示した健宗装置と比較して舞くする(d。くd。)ことができ、また験早が等くなれば光の吸収量も少なくなるので、これに比例して光50の吸収ムラが減少し、電光ムラを軽減防止することがで

-86-

(3)

特朗平4-305915

きるものである.

[0013]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る布希型 舞光製器によれば、 侵骸に界面活性剤を超入することに より、侵略自身の表面張力を焚らして離れ性を向上させ るようにしたので、 侵被の襲撃を得くすることができ る。したがって、長板の膜準ムラが小さく、光の吸収を 少なくすることができ、後根による露光ムラを軽減防止 することができる。

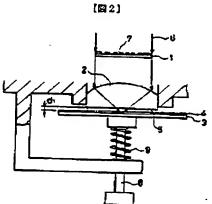
# 【図面の簡単な説列】

【図1】本発明に保る宿着型露光数量の一実施例を示す 夏部の断面図である。

【図2】 密意型電光装置の従来例を示す更能の新面型で ある.

# 【符号の設明】

- 1 フォトマスク
- 2 電光レンズ
- 3 ウエハ
- 4 フォトレジスト
- 5 浸液
- 照射光
- 7 マスク
- 11 非国最长期



# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-305917

(43)Date of publication of application: 28.10.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/027

(21)Application number: 03-094863

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

02.04.1991

(72)Inventor: OZEKI HISAO

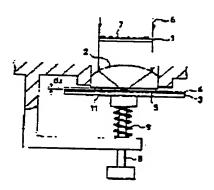
MATSUBARA TAKASHI

# (54) ADHESION TYPE EXPOSURE DEVICE

# (57)Abstract:

PURPOSE: To thin film thickness of an immersion liquid and reduce the quantity of light absorbed, and to minimize and prevent exposure unevenness in an adhesion type exposure device.

CONSTITUTION: The adhesive surface 11 of an exposure lens is hydrophilic- treated by a hydrophilic solution such as alcohol. A wafer 3 coated with a photoresist 4 is fast stuck on the hydrophilic-treated adhesive surface 11 through an immersion liquid 5, and the pattern 7 of a photomask 1 is transferred onto the wafer 3 by the irradiation of irradiation light 6. Wafer absorbing properties are improved in the hydrophilic-treated adhesive surface 11, and the film thickness of the immersion liquid 5 is made thin.



# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出關公則委号

# 特開平4-305917

(43)公债日 平成4年(1982)10月28日

(51) Int.Cl. 4 H 0 1 L 21/027	裁別配号	庁內登理書号	Fl		数勒表示督所
		7019—4 <u>M</u> 7352—4 <u>M</u>	H01L 21/30	341 S 311 A	

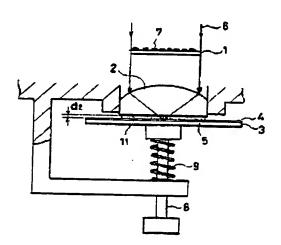
		等登録状 未翻求 請求項の数1(全 3 頁)
(21) 出題番号	特度平3-94863	(71)出題人 000004112
(22) 出題日	平成3年(1991)4月2日	株式会社ニコン 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 (72)発明者 大岡 尚夫 東京都品川区西大井一丁目6番3号 株式
		会社ニコン大井製作所内 (72)発明者 松原 隆 東京都品川区西大井一丁自6番3号 続式
		会社ニコン大弁製作所内 (74)代理人 弁理士 山川 政治

# (54) 【発明の名称】 密管型質光製図

# (57) 【要約】

【目的】 密着型露光装置において、受液の試算を称く して光の吸収量を少なくし、磐光ムラを経滅防止するこ とを目的とする。

【賛成】 電光レンズの密装面11をアルコール等の観 水溶液によって親水化処理する。この親水化処理された 密着面11にフォトレジスト4を整布されたウエハ3を 足紋 δ を介して告着させ、限射光 6 の原射によりフォト マスク1のパターンでをウエハ3上に転写する。 観水化 処理された密着面11は、敷木性が向上し、殺被5の膜 厚を薄くする。



### 【特許競技の範囲】

【餅求項1】 投影光学系もしくはフォトマスクのウエ 八杏若面を額水化処理し、この観水化処理された密着面 にフォトレジストを盤布されたウエハを提復を介して密 岩させ、照射光の照射によりフォトマスクのパターンを 前記フォトレジストに転写するようにしたことを特徴と する密着型露光装置。

# 【発明の詳細な説明】

100011

【座業上の利用分野】本発明は、LSIの製造工程にお 10 いて、フォトマスク上のパターンをウエハ上に役影屈光 する露光表包、特に密管型露光被置に関するものであ る.

### [0002]

【従来の技術】 レーザー光等を照射しフォトマスク上の パターンを投影光学系によってシリコンウエハ等の半導 体基板上に投影電光するこの種の電光装置における電光 方式としては、①密希(コンタクト)電光方式、②プロ キシミティの光方式、③反射型投影の光方式、④柿小レ ンズ登影摩光方式の4方式が知られている。

【0003】このうち密着電光方式は、フォトマスク (または投影光学系) とウェハとを密着させて観光する もので、これらが完全に依着している場合には、フォト レジスト中の波長が腐折率分の1に短くなるため、固折 の影響が少なく、高解像皮の転写が得られるという特色 を有している。しかし、完全な密管を実現することは極 めて難しく、またフォトマスクとウエハとを機械的に接 **独させているためにウエハ表面の突起等によりフォトマ** スクに欠陥が生じ、その寿命を低下させると同時にデバ イスの歩空りに影響を及ばすといった問題があった。

【0004】そこで、宿着蝦光方式によるこのような問 類を解決する方法としてフォトマスクとウエハ間に設体 (投設)を充填している。 図2は投影光学系にウエハを 告着させた場合を示すもので、1はフォトマスク、2は 投影光学系の一部を構成する鑑光レンズ、3はフォトレ ジスト4が整布されたウエハ、5は露光レンズ2とウエ ハ3間に充填された侵族、6はフォトマスク1のパター ン?を無射しフェトレジスト4を開光する照射光、8は ウエハ3を保持する保持体、9は保持体8を上方に付勢 しウエハ3を露光レンズ2に押し付ける圧縮コイルばね である。 無射光 6 の波長は短いほど回折の影響が少な く、そのため光頭としてエキシマレーザー等のレーザー 徳置が用いられる。 役被5としては、 頭折率がフォトレ ジスト4と同程度で光の吸収が少なく、しかもフォトレ ジスト4を繋がさないものが建立しく、過常純水が使用 される。

# [0005]

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上述し たような受放5を使用した密着型像光线層においては、 没被5自身の旗厚ムラがあると、没被5による場射光6 50 露光装置によれば、投影光学系をたはフォトマスクのウ

の吸収量にムラが生じるため、コンタクト電光されたフ オトレジスト4のパターンが的確に膨光されている部分 とそうでない部分とが生じてしまうという問題があっ た。したがって、このような観光ムラの発生を防止する ため、程被5の膜厚は1を薄くし、光の吸収ムラを少な くすることが望まれている。

【0006】本発明は上途したような従来の問題点およ び要望に進みてなされたもので、その目的とするところ は、浸液の原料を築くし、露光ムラを軽減防止し得るよ うにした密着型露光装置を提供することにある。

[0007]

【政策を解決するための手段】本発明は上記目的を達成 するため、投影光学系もしくはフォトマスクのウエハ密 着面を超水化処理し、この親水化処理された密着面にフ ォトレジストを塗布されたウェハを浸液を介して密管さ せ、照射光の照射によりフォトマスクのパターンを前記 フォトレジストに転写するようにしたものである。

100081

[作用] 本発明において、製水化処理された投影光学系 20 もしくはフォトマスクのウエハ密着面は、吸水性が向上 し、受液の膜厚を誇くする。

[0009]

【実施例】以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて 詳細に説明する。図1は本発明に係る徳者型離光装置の 一集絵例を示す要部の断面図である。なお、図中図2と 同一構成部品のものに対しては同一符号を以て示し、そ の説明を省略する。本実施例は投影光学系にウエハぞ徳 殺させた場合を示すもので、フォトマスク投影光学系の 一部を構成する露光レンズ2のウエハ密若面11を予め め 親水化処理し、この親水化処理された倍増面11にウエ ハ3を施水等の浸漉5を介して寄着させ、風射光6の服 針によりフォトマスク1のパターンでをウエハ3上に転 写するようにしたものである。

【0010】 仮水化処理は、アルコール系等の額水溶液 で務着面11を奇隆に拭き、レンズ表面の汚れを取るこ とで行なわれる。そして、この親水化処理後密着面11 にウエハ3を投液5を介して倍着させ、ウエハ3を発光 レンズ2にばわ9により所定圧にて押しつける。

【0011】 かくしてこのような構成においては、親水 40 化処理によって密着面11の吸水性を向上させているの で、蜆木化処理を施さなかったときと比較して浸液5の 吸水効果が大きく、したがって、投液5の衰固張力が小 さくなって濡れ性が上がるため、浸漱5の膜厚d2 を図 2に示した従来装置と比較して輝くする (d2 <d1) ことができ、また膜原が謎くなれば光の吸収量も少なく なるので、これに比例して光の吸収ムラが減少し、軽光 ムラを軽減防止することができる。

-[0012]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る密着型

(3)

特朗平4-305917

エハ密容面を観水化処理し、この観水化処理された密管 節に、フォトレジストを整布されたウエハを侵袭を介し て告考させるように構成したので、民族自身の表面協力 を減らして遅れ性を向上させることができる。したがっ て、役役の腕厚を輝くするができ、また臓原が薄くなれ ば没被の鉄厚ムラも少なくなるため、光の吸収が少な く、役骸による魔光ムラを軽減防止することができる。 【図面の簡単な説明】

【四1】本発明に係る作者四韓光装置の一実施例を示す 要認の断面図である。

【図2】密着型線光装配の従来例を示す妥協の耐面図で

ある.

【符号の説明】

1 フォトマスク 2 尾光レンズ

3 ウエハ

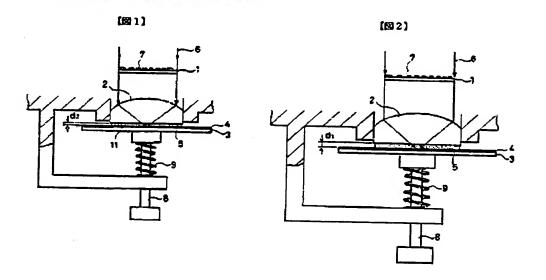
4 フォトレジスト

反放

照射光

7 マスク

10 11 密装面



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: \_\_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.